

证券代码：301568

证券简称：思泰克

厦门思泰克智能科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	广发证券（孙柏阳、汪家豪、朱宇航、肖镇波）、富国基金（罗松）、泓德基金（于浩成、李昕阳）、山东财金资本（刘书君）、深圳前海华杉投资（申玉婷）、上海途灵资产（赵梓峰）、摩根士丹利基金（贾昌浩）、光大永明资产（蒋冰）、友邦人寿保险（许敏敏-Nancy）、国泰基金（谢泓材）、上海彤源投资（潘贻立）、国泰投信（李傍傢）、中银基金（张欣仪）、英大保险（李海）、上海泉汐投资（于苏龙）、申万菱信基金（刘世昌）、华安基金（马丁）、中加基金（苗超）、建信基金（林亮宏）、中信证券（李旭峰）、仁桥（北京）资产（郭航）、湖南源乘私募（邬安沙、高飏）、广发基金（李雅哲） （排名不分先后）
时间	2025 年 8 月 28 日至 2025 年 8 月 29 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长：陈志忠先生 副总经理、董事会秘书、财务总监：黄毓玲女士 证券事务代表：兰邦靖先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、董事长介绍公司基本情况及 2025 年上半年经营情况总结 1. 公司简介 思泰克是一家集机器视觉检测设备的研发、生产、销售及相关的技术服务于一体的具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。公司自 2010 年成立以来，始终坚持走“研发创新驱动变革，智能制造引领生活”的特色发展之路，通过在该细分领域的

	不断探索与创新,有效推动电子装备全产业链的生产效率和智能化水平,为产品质量保驾护航,实现下游厂商的高质量发展。 2. 公司从事的主要业务 公司主营产品为 3D 机器视觉检测设备,主要包括三维锡膏印刷检测设备(3D SPI)及三维自动光学检测设备(3D AOI),主要应用于电子装配领域核心制程的质量管控,覆盖 PCB 的 SMT 生产线品质检测、半导体后道封装工艺检测——包含系统级封装工艺(SIP)、芯片键合(DIE Bonding)、引线键合(Wire Bonding)及倒装连接(Flip Chip Bonding)等工艺的精密量测等关键环节,终端产品应用领域广泛,包括消费电子、半导体、算力服务器、汽车电子及锂电池、通信设备等应用领域。 3. 公司 2025 年上半年经营情况 2025 年上半年,公司实现营业总收入 18,895.49 万元,较上年同期增长 40.23%,实现归属于上市公司股东的净利润 4,475.81 万元,较上年同期增长 36.61%。分产品来看,锡膏印刷检测设备实现营业收入 13,468.45 万元,同比增长 35.70%,自动光学检测设备实现营业收入 3,815.17 万元,同比增长 56.81%。 公司 2025 年上半年具体经营情况,可参见披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》。 二、问答交流 1. 公司上半年增长主要来源于哪些板块,在手订单情况是否良好? 回复:受益于消费电子需求回暖、新能源车渗透率的提升以及算力服务器需求的增长,公司 2025 年上半年,公司实现营业总收入 18,895.49 万元,较上年同期增长 40.23%,实现归属于上市公司股东的净利润 4,475.81 万元,较上年同期增长 36.61%。截至 2025 年 6 月 30 日,公司在手订单情况良好。 2. 请介绍下公司在技术研发上的投入情况,目前专利情况如何? 回复:公司始终将提高企业核心技术优势作为发展的基石。为保持在行业内的技术领先地位,公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年半年度研发投入分别为 2,582.45 万元、3,592.04 万元、
--	---

	1,871.64 万元,占营业收入的比例分别为 7.02%、10.30%、9.90%。 研发费用的持续投入、完善的研发管理和较强的研发团队为公司形成体系化的技术升级能力和打造不断深化的技术创新优势提供了重要保障,也为公司积累了大量技术成果。截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计获得各项知识产权达到 87 项,其中发明专利 9 项、实用新型 37 项、外观设计 8 项、软件著作权 33 项。 3. 公司 3D 机器视觉检测技术相较于 2D 技术的优势? 回复: 公司设备所采用的 3D 机器视觉检测技术均为公司自研,相较于 2D 机器视觉检测技术,具有更为智能、精准及多样化的检测内容及检测效果,具体优势包括: 1) 误检率优势:单一的 2D AOI 在部分检测单项中存在较大缺陷,如无法区分相同颜色物体之间的特征或检测接触侧的物体之间的位置,同时特别依赖于光照、颜色或灰度的变化,测量精度易受照明环境的影响,使得出现误判的概率大幅提升。3D 技术引入了高度等三维测量数据,通过还原了被检测物体的三维图像,解决了由于颜色相同、物体接触等导致的检测不敏感问题,进而大幅降低了误检率。 2) 检测能力优势:3D 检测技术可以测量包括高度、角度、平面度、厚度、体积、颜色相近表面等信息,通过更丰富的数据采集获取物体的三维图像,同时,3D 检测技术可以根据上述测量数据设置公差,进而以超出公差为标准检测缺陷,具备更广的检测能力。 3) 数据优势:传统的 2D 产品仅能发现缺陷但难以计量,应用了 3D 检测技术的设备可以实时获取被检测物体缺陷的定量数据,包括高度、体积、焊点形状等几乎所有关于尺寸的缺陷数据,通过 SPC 软件对检测前工序进行数据分析及工艺改善,提高生产线整体的制程能力及工艺水平,进一步提高产品质量并降低生产成本。 4. 公司主要下游领域有哪些,公司主要的客户有哪些? 回复: 公司终端产品应用领域广泛,包括消费电子、半导体、算力服务器、汽车电子及锂电池、通信设备等应用领域。凭借高性能的检测设备、强有力的研发支撑与完备的营销网络,公司的 3D 机器视觉检测设备产品获得了包括富士康、鹏鼎控股、小米、
--	---

	扬杰科技、京东方、海康威视等各下游领域龙头客户的订单和认可。 5. 可以介绍下公司“标准化生产+半定制化开发”的生产模式吗？ 回复：公司采取“标准化生产+半定制化开发”的生产模式。外协加工商对零部件进行标准化生产，公司在此基础上完成半定制化开发。标准化生产涉及的主要是非核心工艺环节，包括机加工、布线、电箱组装及部分外壳组装等，半定制化开发涉及的主要是核心工艺环节，包括调整关键件配置与搭载特定功能软件模块。公司会结合客户实际检测需求、预算范围及技术要求，选择最恰当的软硬件技术方案。 6. 可以介绍下公司投资的华睿芯材与思坦科技吗？ 回复：华睿芯材成立于 2021 年，专注于半导体光刻胶及其相关化学品等关键微电子材料的研发，以及半导体高端光刻胶的产业化适配和量产。华睿芯材核心团队成员主要来自清华大学，是国内为数不多能自主全面掌握光刻胶核心原材料—成膜树脂制备的企业。 思坦科技成立于 2018 年，是由刘召军等三位国家特聘专家及南方科技大学联合创立，致力于高性能 Micro LED 芯片与显示模组的研究和生产。主要产品是 Micro LED 发光芯片、驱动芯片与显示模组，主要客户为终端 AR/VR 整机制造厂商、光波导厂商、腕表制造厂商及显示屏厂商等。
附件清单(如有)	无
日期	2025-08-29